

PROGRAMMKOMMISSION

Vorsitzender der Programmkommission

U. Bechtloff, KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf

Wissenschaftlicher Tagungsleiter

K.-D. Lang, FhG-IZM, Berlin

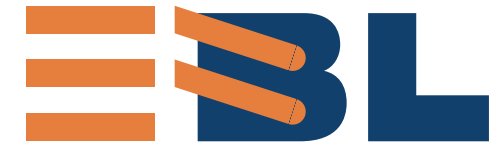
Mitglieder

A. Biener, FUBA Printed Circuits GmbH, Gittelde
J. Denzel, EADS Deutschland GmbH, Ulm
R. Dietrich, Lackwerke Peters GmbH + Co. KG, Kempen
M. Eisenbarth, Continental Teves AG & Co., Ingolstadt
J. Gamalski, Siemens AG, Berlin
W. Grönig, Arden-Verfahrenstechnik GmbH, Velbert
W. Kempe, DaimlerChrysler AG, Sindelfingen
J. Kostelnik, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Rot
K. Lindner, Rimsting
S. Mahlstedt, DVS e.V., Düsseldorf
E. Maier, VDMA e.V., Frankfurt
J. Murawski, Würth Elektronik GmbH & Co., Niedernhall
R. Myllylä, Universität Oulu, Finnland
J. Nicolics, Technische Universität Wien, Österreich
M. Nowotnick, Universität Rostock
H. Schenk, Freudenberg Mektex GmbH, Weinheim
R. Schließer, VDI/VDE-Innovation+Technik, Berlin
G. Schmitz, Robert Bosch GmbH, Stuttgart
R. Schnabel, VDE/VDI-GMM, Frankfurt
H. Schweigart, Dr. O.K. Wack Chemie GmbH, Ingolstadt
R. Schulze, BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Riesa
C. Stoppok, ZVEI, Frankfurt
H. van't Hoen, Chemet GmbH, Wirges
J. Weber, Zollner Elektronik AG, Zandt
M. Weinhold, PBW Consulting Weinhold, Königswinter
M. Weinreich, DVS e.V., Düsseldorf
K. J. Wolter, Technische Universität Dresden

KONFERENZSEKRETARIAT

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und
Feinwerktechnik (GMM)
Telefon +49(0) 69 / 6308 - 227
Fax +49(0) 69 / 6308 - 9828
E-Mail gmm@vde.com
<http://www.ebl-fellbach.de>

PARTNER



Elektronische Baugruppen und Leiterplatten



Call for Papers

Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008

Systemintegration und Zuverlässigkeit

4. DVS/GMM-Tagung

13. – 14. 2. 2008

Schwabenlandhalle Fellbach

www.ebl-fellbach.de

Titelbild: Wirebonding of Stacked IC "High-Density Capacitive Interface for 3D System Integration" Drahtbonden gestapelter ICs, Copyright: Fraunhofer IZM 2006, Fotograf: Armin Okulla

DVS
DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN

GMM

ZIELSETZUNG DER TAGUNG

Da die Anforderungen an eine Elektronik-Baugruppe hinsichtlich Funktionalität, Integrationsdichte und Zuverlässigkeit entsprechend den Anwendungsgebieten sehr unterschiedlich sind, werden ein angepasstes Design, die Beherrschung einer geeigneten Aufbautechnologie und die richtige Teststrategie zu entscheidenden Kriterien, um kostengünstige und zuverlässige Gesamtsysteme zu realisieren. So werden beispielsweise bei Anwendungen im Automobilbereich Lösungen für erhöhte Betriebstemperaturen, hohe Leistungsdichten und hohe Zuverlässigkeiten gefordert. Der Einsatz im Kommunikationsbereich ist dagegen von einer hohen Integrationsdichte bei gleichzeitig hohem Miniaturisierungsgrad des Gesamtsystems geprägt.

Es gibt heute Integrationskonzepte, die auf Basis von organischem Substratmaterial auch kompatibel zu modernsten Bestückungs- und Kontaktierungstechniken sind (z.B. Leadless SMD, Flip Chip, Fine Pitch-Wire Bonding). Hohe Anforderungen an die Leiterplattenfertigung und die dabei verwendeten Materialien (z.B. Lötstopplack, Dielektrika) können hier ebenso erfüllt werden wie auch die durch die Bleifrei-Verordnungen ausgelösten Veränderungen in der Prozessführung.

Zur Realisierung von Hochleistungsbaugruppen oder bei starker Miniaturisierung werden verstärkt 3D-Aufbautechniken wie z.B. das 3D-PCB-Stacking oder das Falten von bestückten Flex-Aufbauten nachgefragt. Neueste Technologien positionieren hier die aktiven Bauelemente nicht nur auf dem Substrat, sondern integrieren diese auch in das Substrat.

Zukünftige Herausforderungen für die Baugruppenintegration (System on Board) sind des Weiteren das Assemblieren von sehr kleinen und sehr dünnen Halbleiterchips, das Einbinden von polymerischen Komponenten sowie die Entwicklung geeigneter Kühlungskonzepte.

Die Konferenz und Fachausstellung „**EBL 2008**“ (www.EBL-Fellbach.de) in Fellbach hat sich im Rahmen der Material-Fertigungs- und Zuverlässigkeitsbetrachtung von elektronischen Baugruppen als die führende Präsentations- und Diskussionsplattform für Fachleute und Neueinsteiger im deutschsprachigen Raum etabliert. Es gelingt den Veranstaltern und Organisatoren immer wieder, heutige und zukünftige Schwerpunktthemen und Anwendungsergebnisse durch Vorträge aus Industrie und Wissenschaft exzellent darzustellen und mit den Kongressteilnehmern zu diskutieren. Die begleitende Ausstellung mit neuesten Firmenentwicklungen fördert zusätzlich den Erfahrungsaustausch zwischen Forschern, Produktentwicklern, Dienstleistern und Fertignern.

Wir würden uns freuen, Sie in Fellbach zu treffen.

Dr. Udo Bechtloff
Vorsitzender Programmkommission

Dr. Klaus-Dieter Lang
Wissenschaftlicher Tagungsleiter

THEMEN DER TAGUNG

Entwicklungstendenzen der Baugruppentechologie

- ◆ Roadmapping
- ◆ Systemintegration
- ◆ Multifunktionale Leiterplatte
- ◆ Integration aktiver und passiver Bauteile
- ◆ Polymerelektronik
- ◆ Entwärmungskonzepte

Substrate und Bauelemente

- ◆ Hochtemperatur
- ◆ Hochfrequenz
- ◆ Leistungselektronik
- ◆ Höchstintegration

Baugruppenfertigung und Verbindungstechnik

- ◆ Pastenapplikation
- ◆ Löten / Kleben / Bonden
- ◆ Einpresstechnik
- ◆ Bestückung
- ◆ Reinigen und Schützen
- ◆ Traceability
- ◆ Recycling

Erfahrungen mit „bleifrei“, 2 Jahre danach

- ◆ Lotauswahl
- ◆ Fehlermechanismen
- ◆ Prozessfenster
- ◆ Bauelemente / Leiterplattenaufbau
- ◆ Anwendung von Standards
- ◆ Arbeitssicherheit

Baugruppenzuverlässigkeit

- ◆ Testverfahren/ beschleunigte Testverfahren
- ◆ belastungsgerechte Prüfung
- ◆ mechanische und thermomechanische Simulation
- ◆ Schadensanalytik
- ◆ Lebensdauerprognose

Prozess- und Produktprüfung

- ◆ Diagnostik (prozessbegleitend) und Qualitätssicherung (z.B. Röntgen, AOI, Ultraschall)
- ◆ Prüftechnik: Teststrategien /-Konzepte
- ◆ Verbesserung der Fehlererkennung

EINREICHUNG VON BEITRÄGEN

Erbeten wird eine ca. 200 Wörter umfassende Kurzfassung. Unbedingt notwendig ist die vollständige Angabe der Adresse des Autors/Vortragenden: Vorname, Name, Firma / Institut, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, E-Mail.

Kurzfassungen müssen bis zum

15. Juni 2007

eingereicht werden. Die Beiträge werden in einem elektronischen Tool gesammelt, dass Sie unter

www.ebl-fellbach.de

finden.

Die Programmkommission wählt die eingereichten Beiträge nach folgenden Kriterien aus:

- ◆ Die Arbeit ist neu und an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veröffentlicht worden.
- ◆ Die Zielsetzung und die Ergebnisse der Arbeit und wie die Arbeit den Stand der Technik voranbringt, muss klar beschrieben sein.

Die Programmkommission behält sich das Recht vor, als Vortrag eingereichte Beiträge bei der Programmgestaltung in die Posterschau zu nehmen, wenn dies sachlich sinnvoll erscheint (daraus ist **keine** Wertung abzuleiten!).

Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde, und erhalten eine Schreibenleitung für ihr Manuskript sowie eine Dokumentvorlage, die die notwendigen Formatierungen für das Abfassen des Textes enthält. Posterautoren erhalten zudem die notwendigen Angaben für die Erstellung des Posters.

Die Manuskripte müssen bis zum

1. Dezember 2007

beim Veranstalter vorliegen.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Es wird ein zitierfähiger Tagungsband erstellt, der den Teilnehmern zu Beginn der Tagung zur Verfügung gestellt wird.